

米韓「7,000億ドルAI連合」の衝撃：日本企業への追い風と構造的リスク

【強い追い風】半導体製造装置・材料への波及効果

日本製製造装置の販売高が過去最大級へ

7.4兆円

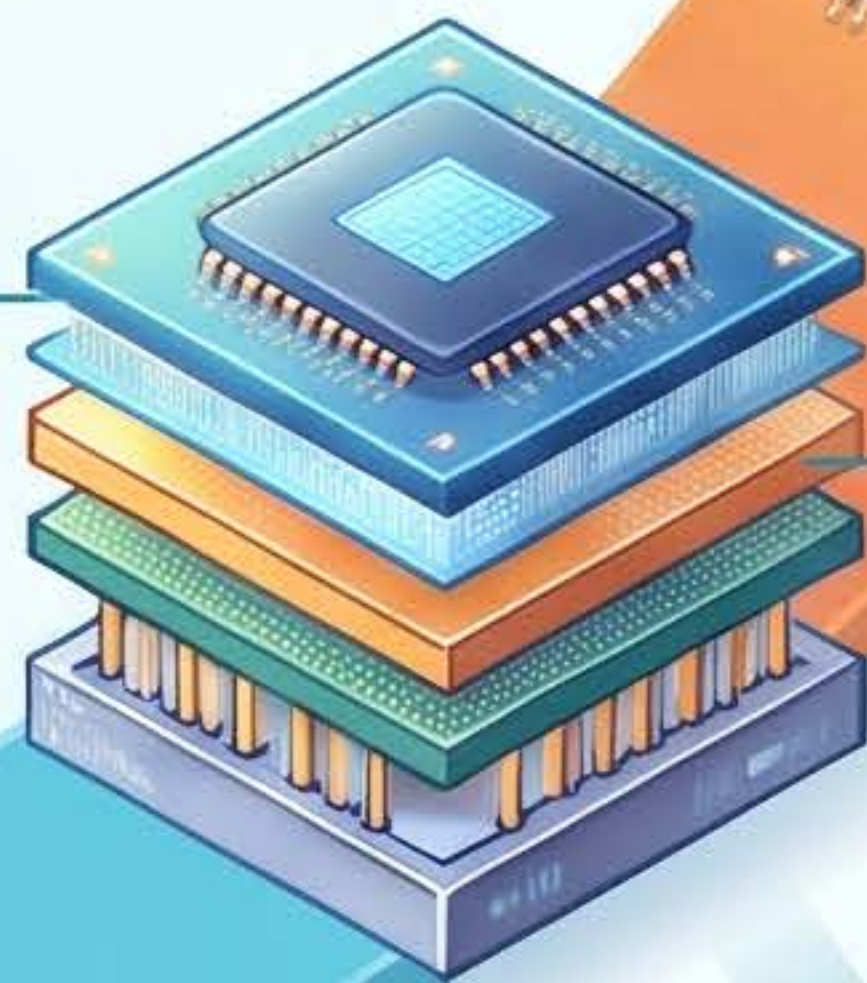
HBM投資急増により、2027年度予測が
半年で1兆円上方修正

HBM製造工程における
材料・装置の圧倒的シェア



TSV形成

東京エレクトロン
Siエッチングで
約90%シェア



HBM積層圧縮成形

TOWA:
圧縮成形装置で
圧倒的シェア

封止材・材料

レゾナック (Resonac):
NCF・DAF・CMPスラリーで世界トップ

7,000億ドル
AI連合

次世代技術への移行遅延が
日本勢の受益期間を延長
ハイブリッドボンディング導入遅れで、
材料需要が3～4年延びる見通し

【逆風と構造的リスク】インフラ格差とシステム層の喪失

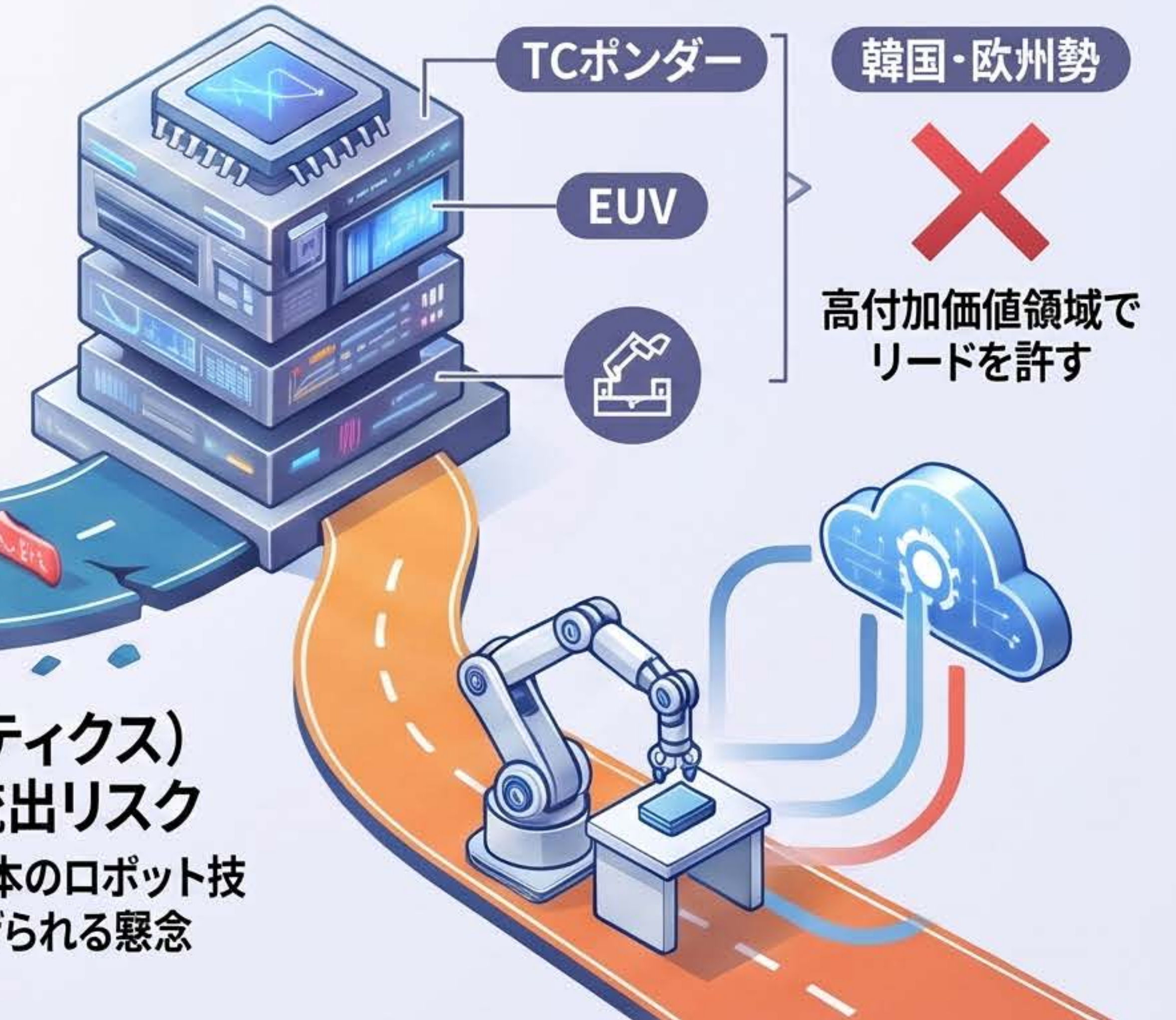
AIデータセンター誘致における深刻なインフラ格差



韓国
国費100%で供給を約束

日本
受電までに最大10年待ち

装置システムの上位レイヤーにおける日本勢の敗退



フィジカルAI (ロボティクス)
における付加価値流出リスク
基盤層を海外に握られ、日本のロボット技
術の利益が上流に吸い上げられる懸念